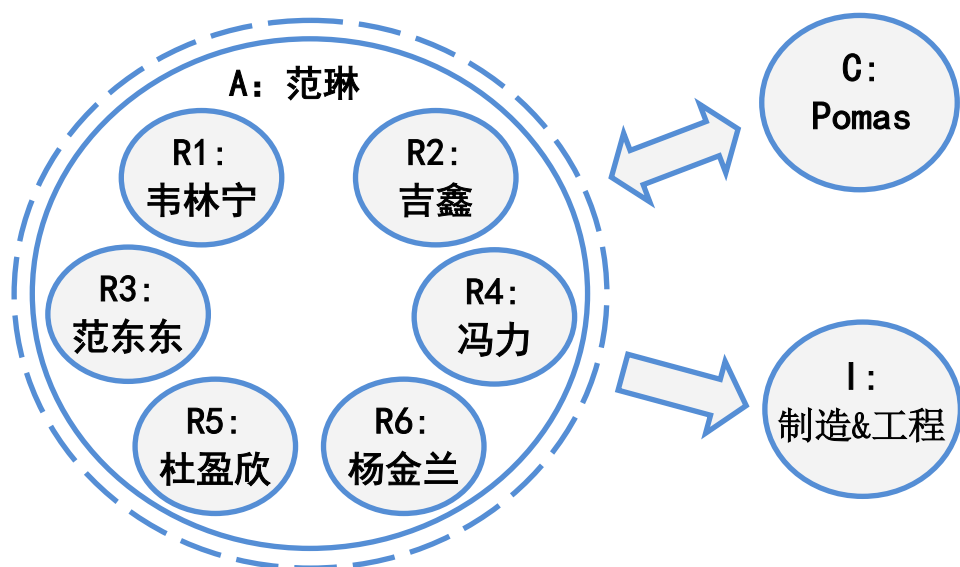


防水机种USB点热熔胶改善

为开拓市场，提升竞争力，公司产品导入防水制程，内部对防水制程也在不断改进，如下防水机种 USB 点热熔胶变更为硅塞，自1月份开始，经过6次试验验证完成，节省人力2人，节省成本约200,000元/年。

团队成员：



A: Accountable 当责者：最终责任者

R: Responsible 负责人：实际完成任务者

C: Consulted

事先咨询者：在“最终决定”或“行动”前必须咨询者

I: Informed

事后告知者：在“决策”后或“行动”完成后必须告知者

专案过程：

3月22日

6th 试验：OK

◇ 试验情况：
(三塞硬度55°&60°)

- 50PCS，良率：100%
- 批量验证：99.63%

◇ 制程变更用于可量产

3月7日

4th 试验：OK

◇ 试验数量：
50pcs*4组(共200pcs)；

◇ 试验情况：
• 硬度55°：
一塞/二塞良率：100%

- 硬度60°：
一塞良率：98%
- 二塞良率100%

◇ 下步行动：批量验证

2月2日

2nd 试验：NG

◇ 试验数量：30pcs

◇ 试验情况：硬度55°&60°&65°
• 不同硬度USB塞工时相差2倍以上，不满足生产。

• USB塞尺寸大于USB

◇ 下步行动：

- 更改USB塞尺寸缩小0.03mm
- 增加USB塞倒角长度0.5mm

6月8日

◇ 量产10K
良率99.94%

3月13日

5th 试验：OK

◇ 试验数量：1473pcs

◇ 试验情况：(硬度55°&60°)

- 一塞良率：
99.8% (3F/1473T)

- 二塞良率：
100% (0F/1473T)

◇ 下步行动：批量验证

3月2日

3rd 试验：OK

◇ 试验数量：20pcs

◇ 试验情况：(硬度55°&60°)

- 一塞良率：100%
- 二塞良率：100%

◇ 下步行动：小批量试验

1月28日

1st 试验：NG

◇ 试验数量：10pcs

◇ 试验情况：硅胶软无法塞进USB接口

◇ 下步行动：
硬度调整由50°→55°/60°/65°

品质知识竞赛

为促进全员『品质海报』阅读，掌握质量知识、提升质量意识，围绕品质海报内容开展全员品质知识竞赛。

- ◇ 时间：4/19日~4/21日
- ◇ 参与人数：115人，参与度：60%。
- ◇ 竞赛成绩分布：(总分：100分)
 - 90~100分：88人，占比77%
 - 80~90分：19人，占比17%
 - 80分以下：43人，占比37%
- ◇ 获奖人员：

员工风采

一等奖*5人



二等奖*10人



三等奖代表(100人)



焊接品质技能竞赛通知

- ◆ 对象：OP & 工程师
- ◆ 竞赛时间：7月24日~25日
- ◆ 报名方式：
扫描如下二维码进行报名



报名时间：7月3日~14日

◆ 奖励机制：

第一名：奖金 300 元

第二名：奖金 150 元

第三名：奖金 100 元

第四~二十名：精美礼品一份

Are you ready?

焊接品质基本要点

PCBa电路板焊接对焊接材料、烙铁温度、焊接时间、作业手法均有要求，在焊接前、焊接中、焊接后的基本要点如下：

焊接前

工作台：清理工作台，保持整洁、干净。

静电防护：防静电设施、静电环。

材料/工具：元件、烙铁、镊子等。

烙铁温度：350°C±10°C

焊接时间：3~5秒，避免重复焊接损伤元件。

焊接操作：元件整齐、居中不移动位置，注意极性。

焊点质量：不可虚焊、假焊、空焊、短路、锡少、锡珠、PCB不可焊脱漆裸铜，焊点周围不可脏污等。

工作台：清理工作台，保持整洁、干净。

材料/工具：整理材料、清理焊接废料、关闭烙铁电源。

焊接中

焊接后